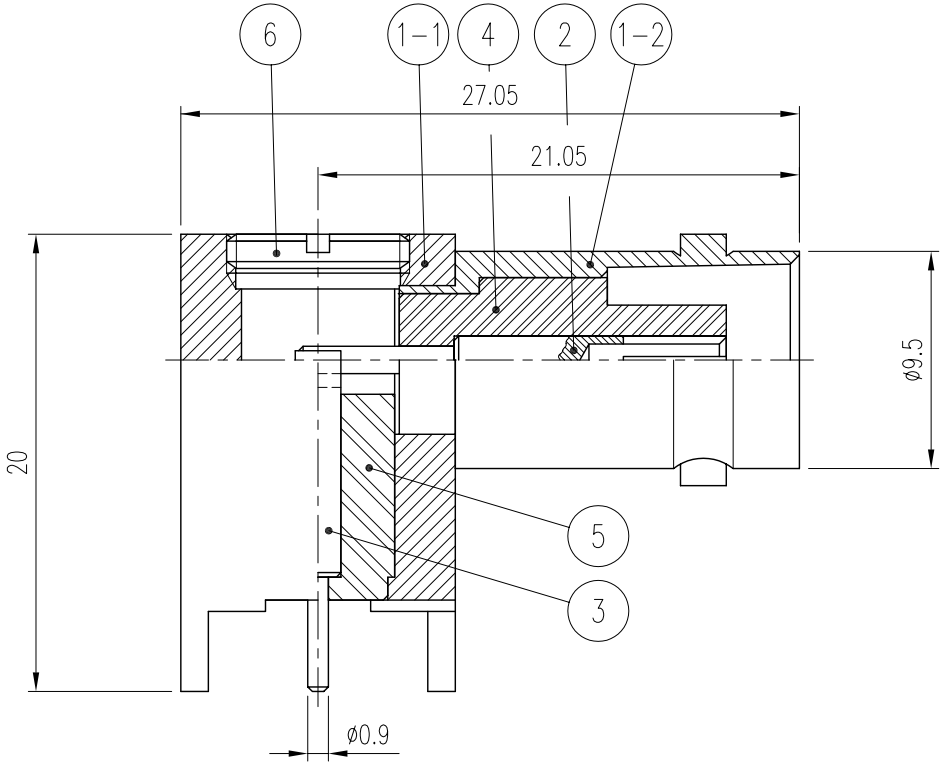
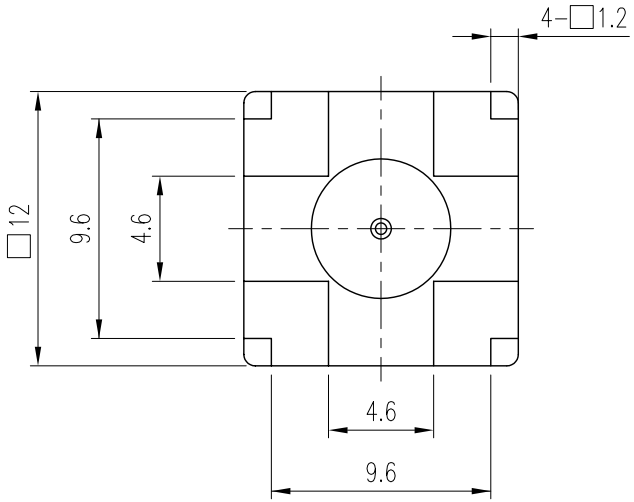
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
6		CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCS00005-5/1 (L6004)	
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00397-N/1 (H6095)	
4		INSULATOR	1	SILICON		DIN00491-N/1 (H6094)	
3		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00468-5/1 (E6082)	
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00520-5/1 (E6081)	
1	1-2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBB00207-5/1	DBD00664-3/1
	1-1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate		DBD00643-3/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2002. 9. 19.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNC50-LJ-4R-R

A4

도번 CN00294-7/1

K325-674-000